



华冠半导体

广东华冠半导体有限公司
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.

制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

DIP-18

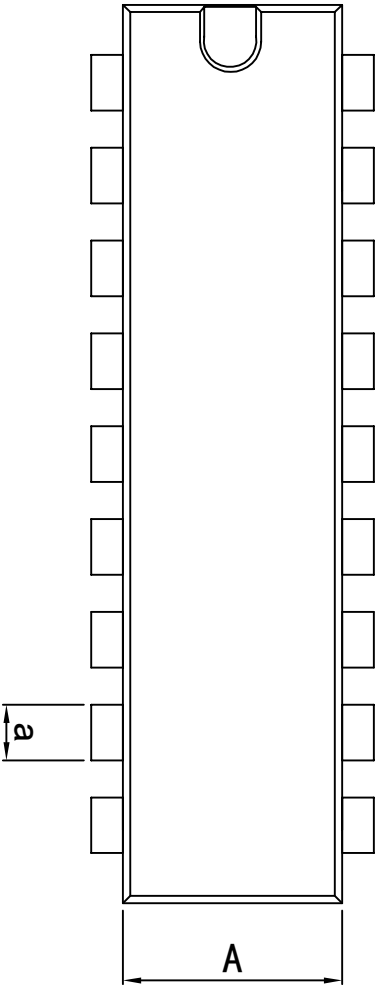
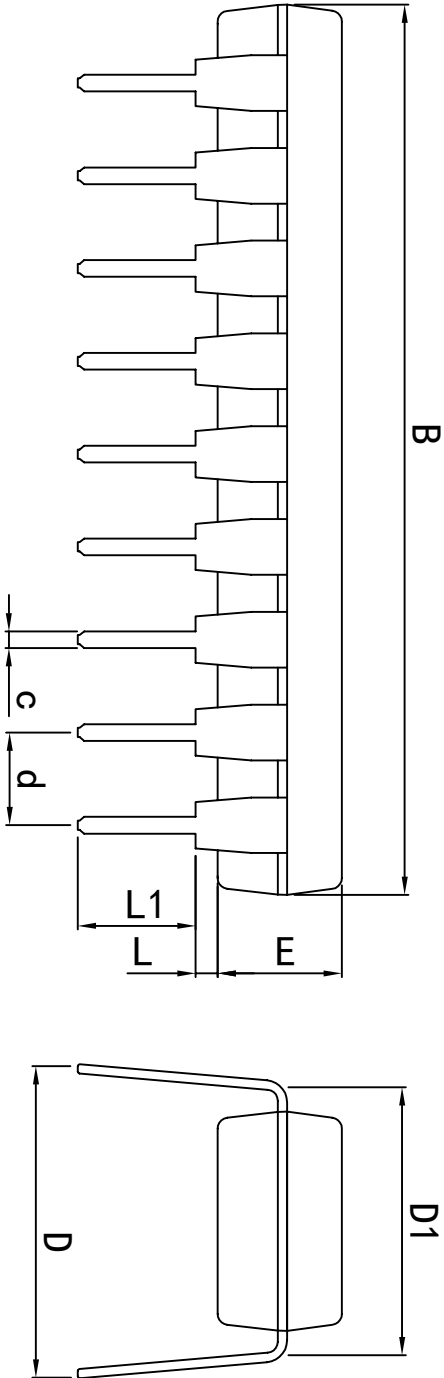
文件名称：
HG-DIP18

文件编号：
HGWXT-230010

版本	V1.0
比例	1:1
单位	mm
日期	2023-6-27
图纸幅面	A4



第一角法



UNITT:mm											
DIM.	A	B	D	D1	E	L	L1	a	C	d	
MIN	6.10	22.24	8.10	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.40	2.54	
MAX	6.68	23.24	10.9	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.50	BSC	